

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者
时间	2025年05月16日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 韩宗远 董事、副总裁 周庚申 副总裁、财务负责人 莫尚云 董事会秘书 钟彦
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司2024年净利润增长很好，净利润也达到了历史最高水平。得益于哪些业务增长呢？ 答:尊敬的投资者，您好！公司2024年归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增加44.33%，主要原因是公司存储半导体业务和计量智能终端业务的增长。感谢您的关注！ 2. 为什么公司现金余额和存款那么多，还需要不断提高短期借款？ 答:尊敬的投资者您好，公司在满足公司日常营运管理等活动需求下，综合市场利率情况，充分考虑融资财务成本后，合理安排融资方式发挥财务杠杆作用，后续将根据资金的实际使用情况适当

	减少短期借款。感谢您的关注！ 3. 公司在合肥的进展情况如何？年报的内容太少了，能否具体说明一下业务及产能使用和扩产能计划？ 答:尊敬的投资者，您好！公司半导体封测业务以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营。2024年度，深圳基地获得智能制造成熟度三级证书，合肥基地获评安徽省数字化车间，公司积极引入新客户、完成现有客户新产品的设计开发和验证，双基地产能产量持续提升。为实现高阶、大容量存储芯片封装，公司积极布局高端封测技术研发。2024年度，公司规划布局的Bumping（凸块）及RDL（再布线层）项目实现量产；超薄存储芯片PoPt封装技术（PackageonPackagetop，叠层封装技术）实现量产；16层堆叠技术和uMCP SiP（超小型多芯片封装系统级）封装技术具备量产能力，同时创新地进行stripFO（条带式扇出型）封装技术的研发；优化多项仿真技术系统，提升研发效率；推动封测材料多元化，多款材料通过测试验证，并导入量产。公司主营半导体封测业务的全资子公司深圳沛顿以及合肥沛顿存储在2024年度均获得国家级高新技术企业认证。未来，公司将以满足重点客户产能需求和加强先进封装技术研发为目标，聚焦SiP封装技术和xPOP堆叠封装技术和车规级产品设计规范的建立，致力成为存储芯片封测标杆企业。2024年度，存储半导体业务营收35.22亿元，同比增长37.62%，业务收入较去年同期有较高增长。感谢您的关注！ 4. 请问公司是否有胜任比如优必选高端人型机器人量产能力？ 答:尊敬的投资者，您好！公司专注于为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流支持等一站式电子产品制造服务，产品可根据需要运用于多种场景。感谢您的关注！ 5. 公司应收帐款接近40亿元，且逐年增长速度超过营收增长速度，请概述一下公司应收帐款的具体情况，是否有大规模坏账风险？公司是否有欠费回收计划？ 答:尊敬的投资者，您好！公司应收账款账龄主要分布在1年以内，公司高度重视应收账款管理，建立了完善的风险管控体系，通过客户信用管理、合同履行跟踪等多重措施保障资金安全。感谢您的关注！ 6. 请问公司有没有收购兼并等资本运作的计划？ 答:尊敬的投资者，您好！公司未来如有相关计划，将严格按照深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务，感谢您的关注！
--	---

	7. 公司在存储封测领域处于什么水平？ 答:尊敬的投资者，您好！作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。感谢您的关注！ 8. 目前公司代工产品组装、质检等流程主要是靠人工，目前各行业机械操作日益成熟，公司有无相关计划优化生产流程，进一步提质增效。 答:尊敬的投资者，您好！深科技提供全面的智能制造技术支撑，搭建了跨系统、精细化的集成信息管控平台与人机协同自动化生产系统。重点推进APS（Advanced Planning and Scheduling，高级计划与排程）、物联网数据采集及微服务MES+等平台的普及实施和深度应用，同时在视觉识别方面开展与MES集成应用。例如，车削工段智能化黑灯车间已全面建成、空中天轨物流已进入全线使用阶段，极大降低了车削工段人工，提升了生产效率，提高了自动化、智能化程度。感谢您的关注！ 9. 公司有没有关于市值管理的内部管理办法？ 答:尊敬的投资者，您好！公司将积极落实证监会发布的市值管理指引和国资委出台的提升央企控股上市公司市值管理意见相关要求，推动健全完善市值管理制度和工作机制。通过不断提升经营质量、优化信息披露、加强投资者沟通、强化投资者回报等手段，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。感谢您的关注！ 10. 公司高端制造、电表的未来规划是怎样的呢？ 答:尊敬的投资者，您好！高端制造业务领域，公司将不断增强高端制造体系化和柔性化能力，通过持续推进数字化赋能与AI的应用，打造智能化、绿色化、协同化的高端电子制造业务，向更具供应链解决方案的制造服务商转型，从中国制造向中国创造转变。面向精益管理、黑灯工厂、智能制造，培育创造新质生产力，从中国速度向中国质量转变；计量智能终端领域，公司将持续开展智能电表、智能融合终端、智能水表及智能燃气表等新一代产品和技术的研究，不断丰富各类智能仪表的功能、提升性能和稳定性；以智能硬件为锚点，加速从计量设备提供商向能源数据价值运营商的战略跃迁。研发集成AI边缘计算模组的下一代感知设备，通过嵌入式神经网络算法实现计量数据的实时清洗与特征提取，为后续深度分析构筑高质量数据基座。同时，继续推进智能工厂建设，通过实施
--	---

	工厂建设、产品设计、工艺设计、计划调度、生产作业、质量管控、设备管理、仓储物流等环节的数字化项目，整体提升智能制造水平。感谢您的关注！ 11. 公司是否具备HBM芯片的封装能力？有没有在HBM封装堆叠方面的研发投入？ 答:尊敬的投资者，您好！作为国内领先的内存芯片封装测试企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力，公司现有的技术水平可以满足现有客户的需求和未来发展需要,未来将根据客户需要布局相关能力。感谢您的关注！ 12. 公司的研发人员增加的比较明显，原因是？ 答:尊敬的投资者，您好！公司研发人员主要增加在存储半导体板块。感谢您的关注！ 13. 公司半导体订单情况如何，有没有扩产计划呢？ 答:尊敬的投资者，您好！公司存储半导体板块以满足主要客户需求来推进扩产计划，二季度订单量较一季度有所增加。感谢您的关注！ 14. 公司具体未来的战略发展是什么？ 答:尊敬的投资者，您好！公司将加强科技创新，着力形成新质生产力，深耕制造业，持续加强关键核心技术攻关，优化科技资源配置，提升科技投入效能，发挥体系化优势，把提升全要素生产率、加快制造业高端化、匹配新型生产关系，作为公司创新引领的主要抓手，不断提高深科技的“科技”含量；公司聚焦主责主业，着力提高发展质量，依托市场化、平台化、国际化优势，加快高端化、智能化、差异化发展。紧跟用户需求推进技术创新，全力夯实存储器封测头部地位。计量智能终端成为“单项冠军”，从中国产品向中国品牌转变。不断增强高端制造体系化和柔性化能力，通过持续推进数字化赋能与AI的应用，打造智能化、绿色化、协同化的高端电子制造业务，向更具供应链解决方案的制造服务商转型，从中国制造向中国创造转变。面向精益管理、黑灯工厂、智能制造，培育创造新质生产力，从中国速度向中国质量转变。贴近客户需求，着力提升产供应链韧性和效能，公司将发挥区域布局优势，适时增加海外布局，贴近客户，增强韧性，形成新的价值链。统筹好现有制造业升级和战新产业培育，在数字化、人工智能、新能源等新赛道呼应客户、及时布局。全面提升创新创效能力和精益管理能
--	---

	力，统筹强内功与拓空间。打破思维惯性，着力优化适应高质量发展的生产关系。为积极应对国际贸易政策变化对全球产业链、供应链带来的影响，公司进一步优化市场布局，积极开拓欧洲等其他国家和地区的市场；调整供应链策略，根据不同国家和地区的贸易政策、成本优势等因素，合理调整生产布局，充分发挥海外生产基地优势；持续深化三项制度改革，加快推进深科技“价值型、赋能型”中央职能部门建设，做到强支撑、强保障，赋能各事业部和工厂业务发展。感谢您的关注！ 15. 子公司开发科技已经在北交所上市了，对公司会有哪些利好？ 答:尊敬的投资者，您好！开发科技在北交所上市，有利于公司计量业务板块做大做强，有利于通过子公司实现价值发现和价值创造，优化公司估值，有利于强化公司资产流动性、降低运行风险。感谢您的关注！ 16. 计量业务的欧洲市场前景预期如何？是否有重点、重大项目规划？是否有计划拓展其他地区市场？ 答:尊敬的投资者，您好！未来随着下游应用领域需求的持续增长和新领域的不断开拓，发展前景良好，经营规模仍将保持持续增长趋势。开发科技也将依托成熟的研发能力、制造能力和供应链优势，继续深化与合作伙伴的全面合作，构建全球营销网络，实现国际和国内业务协同发展。在巩固欧洲市场优势的同时，积极开拓中亚、中东市场，加快培育在国内市场的竞争优势、持续提升行业地位。感谢您的关注！ 17. 请问公司所处的目前半导体行业的情况如何？ 答:尊敬的投资者，您好！根据世界半导体贸易统计组织预测数据显示，2025年全球半导体市场将延续增长态势，市场规模同比增速将达到11.2%，增长至6970亿美元。其中，存储市场将继续受益于AI和高性能计算的推动保持强劲增长。公司从事的封装测试是连接芯片设计与终端应用的关键环节，行业市场集中度较高且市场格局较为稳定，行业前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业所占据，而且这些地区的企业市场份额有进一步提高的趋势。随着摩尔定律逐渐放缓，封装环节对于提升芯片整体性能越来越重要，先进封装具备推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降的巨大潜力，率先拥有先进封装技术和产能储备的封测企业将有望通过技术和规模壁垒取得行业领先优势。感谢您的关注！
--	--

	18. 国家一直处于外界打压之中，很多科技公司已慢慢突围，作为国企央企身份，承担着国家崛起的重担，请问贵公司在国产替代中如何发挥作用？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在国际国内双循环的环境下，积极开拓国内市场。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年05月16日